

製 品 仕 様 書 PRODUCT SPECIFICATION		No,	IS-13014-003	来歴/REV.	0												
		頁	1/2														
標 題 : 13014 シリーズ 2.54 mm ピッチ ピンヘッダー SUBJECT : 13014 SERIES 2.54mm PITCH PIN HEADER		制定年月日 ISSUE DATE		2017-9-13													
		改訂年月日 REVISED DATA															
1. 適用範囲 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 13014 シリーズ 2.54mm ピッチ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の必要事項について 規定する。		1.Scope This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO., LTD. series 13014 2.54mm pitch pin header.															
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する。) 対象製品 : IMSA-13014B-10B-PT1 IMSA-13014B-10C-PT1 IMSA-13014B-08D-PT1		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied for Pb free plate product) Parts No. : IMSA-13014B-10B-PT1 IMSA-13014B-10C-PT1 IMSA-13014B-08D-PT1															
3. 定格 (1)最大定格電圧 : 250V (AC,DC) (2)最大定格電流 : 3A (3)使用温度範囲 : -40～+105℃		3.Rating (1)Maximum rating voltage : 250V (AC,DC) (2)Maximum rating current : 3A (3)Temperature range : -40～+105℃															
4. 試験環境 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15～35℃ 常湿 : 25～85% RH		4.Environmental condition All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition. Ambient temperature : 15～35℃ Ambient humidity : 25～85%RH															
5. 特性 5-1. 電気的性能		5.Performance 5-1. Electrical performance															
<table><tr><th>項目/ITEM</th><th>条 件/Test condition</th><th>規 格/Specification</th></tr><tr><td>1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage</td><td>端子相互間に AC500V を 1 分間印加する。 AC 500 V shall be applied for one minute to between next terminals</td><td>異常なきこと No changes.</td></tr><tr><td>2 絶縁抵抗 Insulation resistance</td><td>端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.</td><td>初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩMIN. After humidity test : 100MΩMIN.</td></tr><tr><td>3 外観 Appearance</td><td>目視 Visual.</td><td>有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、 変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.</td></tr></table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC500V を 1 分間印加する。 AC 500 V shall be applied for one minute to between next terminals	異常なきこと No changes.	2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩMIN. After humidity test : 100MΩMIN.	3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、 変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.				
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification															
1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC500V を 1 分間印加する。 AC 500 V shall be applied for one minute to between next terminals	異常なきこと No changes.															
2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩMIN. After humidity test : 100MΩMIN.															
3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、 変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.															
5-2. 機械的特性		5-2.Functional performance															
<table><tr><th>項目/ITEM</th><th>条 件/Test condition</th><th>規 格/Specification</th></tr><tr><td>1 端子保持力 Post retention force</td><td>端子に 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重 を測定する。 The post shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.</td><td>4.9N 以上 4.9N MIN.</td></tr></table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 端子保持力 Post retention force	端子に 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重 を測定する。 The post shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N MIN.										
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification															
1 端子保持力 Post retention force	端子に 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重 を測定する。 The post shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N MIN.															
5-3. 環境特性		5-3.Environmental performance															
<table><tr><th>項目/ITEM</th><th>条 件/Test condition</th><th>規 格/Specification</th></tr><tr><td>1 耐熱性 Heat resistance</td><td>温度 105±2℃の恒温槽に 164 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 164 hours.</td><td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td></tr><tr><td>2 耐湿性 Humidity</td><td>温度 40±2℃相対湿度 90～95%の恒温恒湿槽に 164 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2℃、 90～95%RH for 164 hours.</td><td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td></tr></table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 164 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 164 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	2 耐湿性 Humidity	温度 40±2℃相対湿度 90～95%の恒温恒湿槽に 164 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2℃、 90～95%RH for 164 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.							
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification															
1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 164 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 164 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.															
2 耐湿性 Humidity	温度 40±2℃相対湿度 90～95%の恒温恒湿槽に 164 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2℃、 90～95%RH for 164 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.															
5-4. その他特性		5-4.Other performance															
<table><tr><th>項目/ITEM</th><th>条 件/Test condition</th><th>規 格/Specification</th></tr><tr><td>1 半田付け性 Solderability</td><td>コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー 槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s.</td><td>浸した面積の 95%以上に半田がむらなく 付着すること。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.</td></tr></table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー 槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s.	浸した面積の 95%以上に半田がむらなく 付着すること。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.										
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification															
1 半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー 槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s.	浸した面積の 95%以上に半田がむらなく 付着すること。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.															

項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification
2 半田耐熱性 Resisting of soldering test	<p>下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions.</p> <p>(1) リフロー条件 / Reflow condition 適用回数/Applied number : 2 / Two times 260℃MAX(ピーク温度) 10sMAX. (Peak temperature)</p> <p>温度はコネクタ上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the connector.</p> <p>(2)手半田 の場合/ In case of manual soldering. 半田鋳温度 / Temperature : 350±5℃ 時間 / Time : 3.0±0.5s</p>	端子のガタ 割れ等のないこと。 Should not have any flaw and scratch.

6. 製品の保管期限

製造日より1年とする。

6.Term of a guarantee

1 year from product day.

7. 奨保存保管条件

室温で-10~+40℃の温度、75%以下の相対湿度で保管して下さい。

7.Recommend Storage conditions

Shall be storage in the house at -10~+40℃,75%RH or less .

8. 使用上の注意

- ・ 嵌合について
挿入の際、こじる事の無い様にゆっくりと嵌合して下さい。
- ・ 接続方法について
コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。
使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板を
ビスにて確実に固定して下さい。
コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても
43.12m/s²以下とする事。
(共振振動が加わらない事。)

8.Attention of using connector

- ・ Mating of connector
When the connector is mating, connector shall not be twisted,
and then mate it slowly.
- ・ Connect of connector
It shall not be held the connector only, when you are
Assembled for the connector and P.C.B.
When it shall be used the connector, the P.C.B. are held
by the rivet certainty near mounting of the connector.
Acceleration of connector : 43.12m/s² or less.
(the connector shall not be added to resonance acceleration)

9. 注意事項

- ・ ウィスカーに関して
本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持た
せた製品ですが、ウィスカーの発生を無くすことを保証
する製品ではありません。

9.Attention

About a whisker
This product has effect to suppress the occurrence of whisker
than normal. However, it is not a product that guarantees that there
is no occurrence of whisker.